

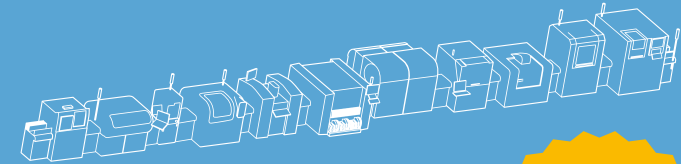
Linienteilnehmer

ATEcare Service GmbH
 BRADY GmbH
 DEK Printing Machines GmbH
 F&K Delvotec
 Fraunhofer IZM
 Handke Industrie Software GmbH
 IBL Löttechnik GmbH
 LPKF Laser & Electronics AG
 Nordson ASYMTEK
 Nordson YESTECH
 Rommel GmbH
 Siemens Electronics Assembly Systems GmbH
 VITECHNOLOGY
 Werner Wirth / PVA

Sponsoren

Murata Manufacturing Co. Lt.
 RAFI GmbH & Co. KG
 Würth Elektronik GmbH & Co. KG
 Zierick / Werner Wirth GmbH

Gemeinschaftsstand Fertigungslinie Future Packaging auf der SMT 2010



Weitere Aussteller

APZ Smart System Integration
 ATEcare Service GmbH
 ERSA GmbH
 Fraunhofer IKTS
 Fraunhofer IZM / MMZ
 Fraunhofer ISIT
 globalPoint ICS GmbH
 Harting AG Mitronics
 KIE GmbH
 Universität Erlangen - FAPS
 PacTech Packaging Technologies GmbH
 Promatix GmbH
 sysCom electronic GmbH
 Wagenbrett GmbH
 Werner Wirth / Zierick

Kontakt

Applikationszentrum Smart System Integration APZ
 am Fraunhofer IZM

Konzeption, Leitung: Harald Pötter
 Tel.: +49 30 46403-136

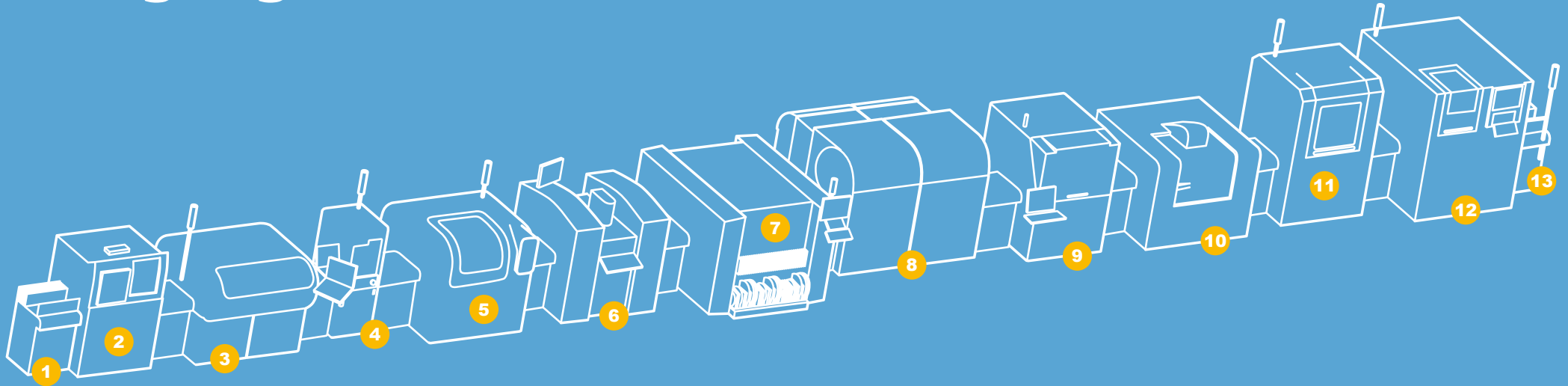
Organisation: Kerstin Hafemeister, Madlen Seyfferth
 Tel.: +49 30 46403-742

Technologie: Erik Jung, Christine Kallmayer,
 Ulf Oestermann, Steve Voges
 Tel.: +49 30 46403-235

Email: info@future-packaging.de
 Web: www.future-packaging.de

FUTURE PACKAGING

Fertigungslinie



1 + 13 Rommel GmbH **2 Brady GmbH** **3 DEK Printing Machines GmbH** **4 Nordson ASYMTEK** **5 ATEcare Service GmbH** **6 F&K Delvotec**
7 Siemens Electronics Assembly Systems GmbH **8 IBL Löttechnik GmbH** **9 ViTECHNOLOGY** **10 Nordson YESTECH** **11 Werner Wirth / PVA**
12 LPKF Laser & Electronics GmbH • Handke Industrie Software Entwicklungsgesellschaft mbH

**FUTURE
PACKAGING**